

диаметром 1.3 м. При линейной скорости вращения диска ~ 20 м/с нижний магнит устойчиво зависал.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Hellman F., Gyorgy E.M., Johnson D.W., O'Bryan J., Sherwood R.C. // Journal Applied Physic. 1988. V. 63(2). P. 447-450.
- [2] Marshall D.B., Dewames R.E., Margan P.E., Ratto J.J. // Appl. Phys. A. 1989. V. 48. P. 87-91.
- [3] Tsukamoto O., Yasude V., Chen J.J. // IEEE Transaction on Magnetics. 1988. V. 24. N 2. P. 1497-1500.
- [4] Reitz J.R., Davis L.C. // Journal of appl. phys. 1972. V. 43. N 4. P. 1547-1553.
- [5] Vander Heide H. // Philips. Techn. Rev. 1974. V. 34. P. 61-72.
- [6] Бонштедт А.В., Широносов В.Г. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 5. С. 82-85.

Отделение физико-технических
проблем транспорта
на сверхпроводящих магнитах
АН УССР, Днепропетровск

Поступило в Редакцию
19 марта 1990 г.
В окончательной редакции
1 марта 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 18

26 сентября 1990 г.

06.3

© 1990

ПЛАНАРНЫЕ PIN-ФОТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР $In_{1-x}Ga_xAs_{1-y}P_y/InP$

М.А. Браер, О.Н. Забенькин,
А.В. Кулыманов, О.В. Огнева,
В.Н. Равич, И.В. Чинарева

PIN-фотодиоды (ФД) на основе гетероструктур $InGaAsP/InP$ - основной тип фотоприемников для волоконно-оптических систем передачи информации (ВОСПИ), работающих в спектральном диапазоне 1.2-1.6 мкм (рабочие длины волн $\lambda_1=1.3$ мкм, $\lambda_2=1.55$ мкм). Их основное преимущество перед германиевыми ФД, предназначеными для того же диапазона длин волн, состоит в возможности получения существенно меньшей плотности темнового тока (j_T), особенно при работе в условиях повышенных температур [1].

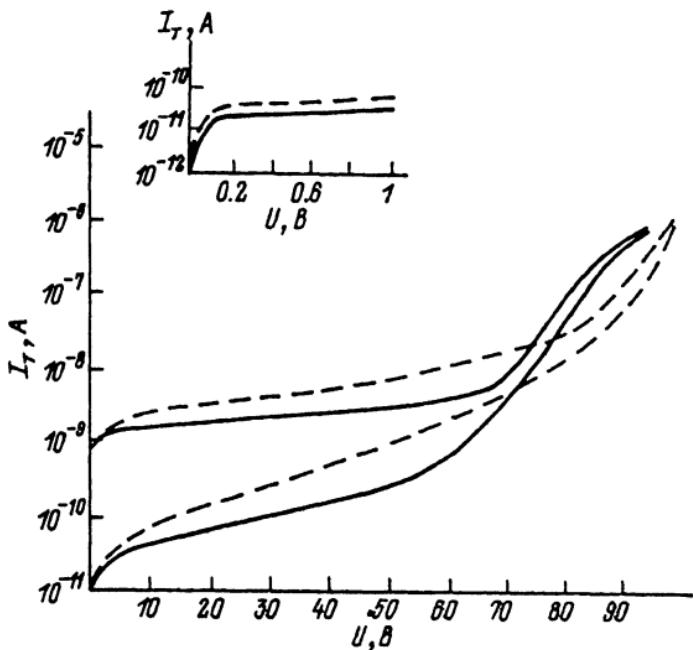


Рис. 1. Обратные ветви ВАХ PIN-ФД с диаметром р-п перехода 200 мкм на основе структур типов 1 (1, 2) и П (3, 4). Т, К: 1, 3 - 293; 2, 4 - 358.

Анализ литературных данных [2-4] показывает, что наиболее перспективной конструкцией PIN-ФД, обеспечивающей высокую стабильность его параметров при длительной эксплуатации, является планарная конструкция прибора. В настоящей работе представлены результаты исследования основных характеристик планарных PIN-ФД на основе гетероструктур $InGaAsP/InP$ в диапазоне температур 213-358 К.

PIN-ФД изготавливались на основе двухслойных структур, выращиваемых методом жидкофазной эпитаксии на подложках InP . В качестве поглащающего слоя использовались соединения двух типов: четверное соединение $In_{0.7}Ga_{0.3}As_{0.6}P_{0.4}/InP$ с шириной запрещенной зоны $E_g=0.9$ эВ (в структурах типа 1) или тройное соединение $In_{0.53}Ga_{0.47}As$ с шириной запрещенной зоны $E_g=0.7$ эВ (в структурах типа П). Слой „окна“ в структурах обоих типов выполняется на основе четверного соединения $In_{0.8}Ga_{0.2}As_{0.4}P_{0.6}$ с шириной запрещенной зоны $E_g=1.1$ эВ. Концентрация электронов во всех слоях $10^{14}-10^{15}$ см⁻³, толщина слоев - 3-5 мкм.

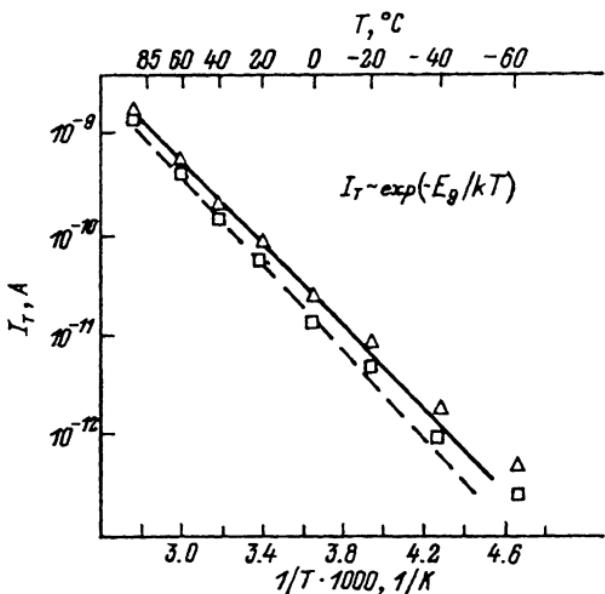


Рис. 2. Температурные зависимости I_T при U_p PIN-ФД с диаметром р-п перехода 200 мкм. Сплошная и штриховая линии – расчетные зависимости для структур типов I и II соответственно.

Фоточувствительный элемент фотодиода (ФЧЭ) изготавливался по планарной технологии. В качестве маскирующего и защитного покрытия использовался слой Si_3N_4 , полученный низкотемпературным плазмохимическим осаждением. Локальные р-п переходы диаметрами 80 и 200 мкм формировались диффузией кадмия. В качестве антиотражающего покрытия также использовался слой Si_3N_4 . Омические контакты создавались напылением в вакууме трехслойной системы $Ti-Pt-Au$. ФЧЭ монтировался в корпус, обеспечивающий стыковку с волоконно-оптическим кабелем через оптический разъем с диаметром соединительного элемента 2.5 мм.

При рабочих напряжениях $U_p = 5$ и 10 В и температуре $T = 293$ К токовая монохроматическая чувствительность ФД на основе обоих типов структур на длине волны $\lambda_1 = 1.3$ мкм $S\lambda_1 = 0.7 - 0.85$ А/Вт. Чувствительность ФД на основе структур типа II на $\lambda_2 = 1.55$ мкм $S\lambda_2 = 0.8 - 0.95$ А/Вт. Коэффициент отражения прозрачного слоя Si_3N_4 в спектральном диапазоне 1.2–1.6 мкм $R = 3 - 5\%$. С учетом потерь на отражение светового сигнала в отрезке световода конструкции ФД, указанным значениям $S\lambda$ соответствует внутренняя эффективность преобразования, близкая к 100%.

В интервале температур 213–358 К чувствительность ФД на основе обоих типов структур на рабочих длинах волн уменьшается с ростом температуры, причем общее снижение $S\lambda$ не превышает 5–7%.

На рис. 1 приведены обратные ветви ВАХ ФД с диаметром р-п перехода 200 мкм на основе структур обоих типов при $T = 293$ К и $T = 358$ К.

Зависимости $I=f(1/T)$ при U_P представлены на рис. 2. При $T=293$ К и $U_P=10$ В величина темнового тока $I_T=60\text{--}500$ нА, что соответствует плотности темнового тока $j=(2\text{--}10) \cdot 10^{-7}$ А/см.². Минимальные значения I_T одинаковы для ФД изготовленных на структурах типов I и П. При увеличении температуры на 10 К I_T увеличивается в 1.3–1.5 раза в диапазоне температур 213–293 К и в 1.5–1.6 раза в диапазоне температур 293–358 К.

Из характера температурных зависимостей I_T в диапазоне 293–358 К следует, что основным механизмом тока PIN-ФД при $U=U_P$ является генерация–рекомбинация носителей в области пространственного заряда (ОПЗ) $p-n$ перехода. Поверхностная составляющая I_T проявляется лишь при температурах, меньших 258 К на фоне общего темнового тока 0.01 нА; вклад диффузионного тока неосновных носителей во всем диапазоне температур заметен только при U , меньших 0.1–0.2 В (вставка на рис. 1). Эффективное время жизни носителей в ОПЗ в соединении $In_{0.7}Ga_{0.3}As_{0.6}P_{0.4}$ $\tau_{\text{эфф}}=1\text{--}5$ мкс, в соединении $In_{0.53}Ga_{0.47}As$ $\tau_{\text{эфф}}=10\text{--}30$ мкс.

Стабильность PIN-ФД при длительной эксплуатации характеризуется, как правило, изменениями I_T [2]. В настоящей работе стабильность прибора оценивалась в ходе ускоренных испытаний, где в качестве ускоряющих факторов использовались повышенная тепловая и электрическая нагрузки [5]. После испытаний разработанных ФД в течение 5000 часов при $T=333$ К и $U=30$ В изменения темнового тока не зафиксировано.

Инерционность PIN-ФД при $U=U_P$ на длинах волн $\lambda_1=1.3$ мкм и $\lambda_2=1.55$ мкм (последнее для структур типа П) не превышала 0.1–0.3 нс; емкость $p-n$ переходов составляла 0.1–0.3 пФ и 0.6–1 пФ при диаметрах $p-n$ перехода 80 и 200 мкм соответственно.

Список литературы

- [1] Техника оптической связи: Фотоприемники / Пер. с англ. под ред. У. Тсанга. М., 1988. 526 с.
- [2] S a u l R.H., C h e n F.S. et al. // AT&T Techn. Journ. 1985. V. 64. N 3. P. 861–881.
- [3] R o b e r t s o n M.J., R i t c h i e S. et al. // Electron. Lett. 1988. V. 24. N 5. P. 252–254.
- [4] M a t s u s h i m a Y., N o d a Y. et al. // IEEE J. of Quant. Elektron. 1985. V. QE-21. N 8. P. 1257–1263.
- [5] Ч е р н ы ш е в А.А. Основы надежности полупроводниковых приборов и интегральных схем. М., 1988. 255 с.

Поступило в Редакцию
2 июня 1990 г.